



技术要求

1. 未注尺寸公差±0.1。
2. 未注倒角C0.5。

			热处理	表面处理
				代号 SY-COM-8DIO-0.5A-NPN
变更版本	变更人签字	日期	材 料	名称 串口IO模块
设计			重量	每台数量 比例
制图				1:1
校对			精度等级	
审核			共 张	第 张
				深圳市双翌 光电科技有限公司